



SnBi系異方導電性接合材／ACF, ACP, コネクター接続代替用

SnBi-solder type Anisotropic conductive paste / Alternative to ACF, ACP, connectors

SAM32

特長 Features

- 工程短縮
- 省スペース軽量設計に最適
- リワーク可能
- ハロゲンフリー / VOCフリー

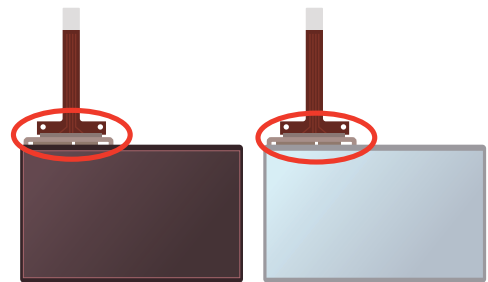
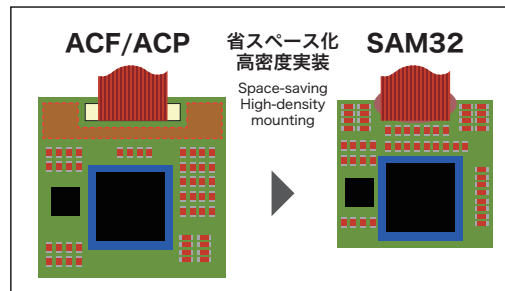
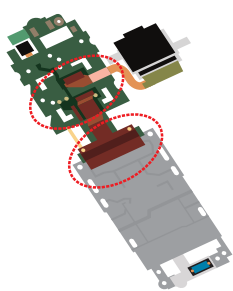
Process time reduction
For space saving and lightweight design
Reworkable
Halogen-free / VOC-free

ラインナップ Line Up

	SAM32-401E-13	SAM32-401F-13	SAM32-401SF-13
		開発品 Under Development	開発品 Under Development
性 状 Component type	ペースト Paste	ペースト Paste	ペースト Paste
はんだ合金組成 Alloy Composition (融 点 Melting point)	Sn58Bi (139℃)	Sn58Bi (139℃)	Sn58Bi (139℃)
はんだ粒子サイズ Particle size	5-20 μ m	3-10 μ m	2-6 μ m
塗布方法 Application Method	ディスペンス Dispense	ディスペンス Dispense	ディスペンス Dispense
標準熱圧着条件 TCB condition	150℃-1MPa-10sec	150℃-1MPa-10sec	150℃-1MPa-10sec
接続用途 Application (適用可能L/S Available L/S)	FOB, FOF (100/100 μ m)	FOB, FOF (50/50 μ m)	FOB, FOF (30/30 μ m)

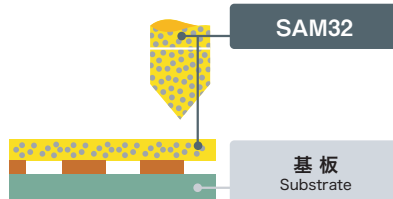
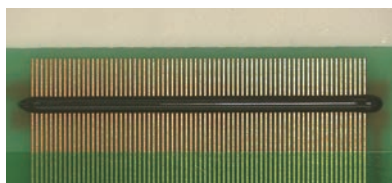
本製品は、パナソニックファクトリーソリューションズ社のライセンスに基づく製品です This product is a product based on the license of Panasonic Factory Solutions Co.

アプリケーション Application



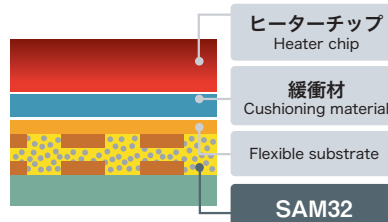
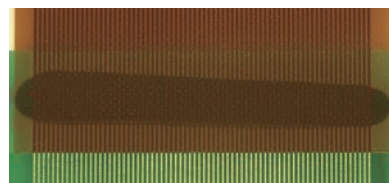
プロセス Process

シリンジによる塗布 Printing with syringe

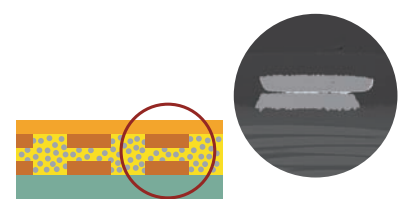
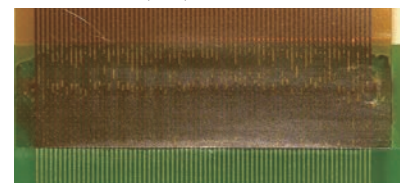


塗布方法：ディスペンス
Application method : Dispensing

位置合わせ Alignment



加熱&加圧 Thermal Compression bonding (TCB)



熱圧着条件 TCB condition :
150℃-1.0MPa-10sec